



2023年2月17日

各 位

会 社 名 ワイエイシイホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 百瀬 武文  
(コード番号 6298 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理統括本部長 畠山 督  
(TEL. 042-546-1161)

### 連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2023年2月17日開催の取締役会において、2023年4月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ワイエイシイデンコーと、同じく当社の連結子会社であるワイエイシイテクノロジーズ株式会社が合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 合併の目的

株式会社ワイエイシイデンコーとワイエイシイテクノロジーズ株式会社は、それぞれ加熱処理装置とドライエッチング装置を主体とし、同じフラットパネルディスプレイ業界向けに装置の製造販売を行っております。特に中国マーケットにおける主要顧客は共通先も多く、両社の統合によるスケールメリットの追求と営業部門の整理統合により、従来以上に攻めの営業展開を図るものであります。

また、調達業務や営業事務、管理部門や品質保証等の間接部門の一元化・効率的な再配置により、生産性や収益性の向上を図るものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 合併決議取締役会（当社）    | 2023年2月17日 |
| 合併契約締結日（合併当事会社） | 2023年2月17日 |
| 合併期日（効力発生日）     | 2023年4月1日  |

##### (2) 合併の方式

株式会社ワイエイシイデンコーを存続会社、ワイエイシイテクノロジーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当はありません。

##### (4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要（2023年2月17日現在）

|               | 存続会社   | 消滅会社  |
|---------------|--|---|
| (1) 名称        | 株式会社ワイエイシイデンコー   | ワイエイシイテクノロジーズ株式会社                                   |
| (2) 所在地       | 東京都青梅市今井三丁目7番地8  | 東京都昭島市武蔵野三丁目10番6号                                   |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 青木 康浩  | 代表取締役社長 村野 恒利                                       |
| (4) 事業内容      | 液晶・OLED ディスプレイ製造用加熱装置、半導体・電子部品製造用加熱装置、自動車部品製造用加熱装置等の製造販売 | フラットパネルディスプレイ製造関連装置、半導体製造関連装置、プラズマ技術を応用した製造装置等の製造販売 |
| (5) 資本金       | 398百万円   | 100百万円  |
| (6) 設立年月日     | 1961年8月25日   | 2016年10月3日  |
| (7) 発行済株式数    | 400万株  | 25万株  |
| (8) 決算期       | 3月31日  | 3月31日   |
| (9) 大株主及び持株比率 | 当社 100%  | 当社 100%   |

### 4. 合併後の状況

存続会社の名称、所在地、事業内容、資本金、決算期、大株主及び持株比率に変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社同士の合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以 上